演題その1

ウィークビーム法を用いた人工 ダイアモンドの3次元トポグラフ

岡本博之¹,水野 薰²,森川公彦²,中野智志³, 1**金沢大医薬保健**,²島根大総合理工,³物質•材料機構

本来の実験目的

- •3次元X線トポグラフィによる高圧実験 用ダイアモンドの事前評価 (どのような結晶が高圧実験に耐えるか)
- 加圧済み結晶を使いダイアモンドの塑
 性変形メカニズムを明らかにする



Diamond Anvil Cell(DAC)

3次元トポグラフで観察された、屋根型の面状欠陥の正体 を明らかにするため、人エダイアモンドで観測された面状欠 陥(積層欠陥)と比較する

今回の目的(準備段階)

ウィークビーム条件を利用した3次元トポグラフ
 法により、人工ダイアモンド中に存在する積層欠
 陥を明瞭に観察する



X線トポグラフィについて

完全性の高い結晶からの回折X線の強度コント ラストを、<u>二次元検出器</u>に投影することによって 結晶を評価する、非破壊的評価手法



S. Kawado and J. Aoyama: Appl. Phys. Lett. <u>34</u> (1979) 428.



Kajiwara et al., Phys. Stat. Sol. 204(2007)2682. CZ-Siのネッキング

人エダイアモンド単結晶



タイプ Ib



スミクリスタル:住友電工



結晶の面指数

使用した結晶の外形

1.0mm

(111)を回折面として使用





まとめ

- ・回折条件を変化させた撮影により、ピーク条件と ウィークビーム条件の二種類の3次元トポグラフが得 られた
- ・二種類の3次元トポグラフで、{111}面に面状欠陥が 観察された
- ・回折面(111)と平行な面状欠陥は観測されなかったので、面状欠陥は積層欠陥と考えられる
- ピーク条件では、周囲に存在する歪に邪魔されて積
 層欠陥の形状が不明瞭であるが、ウィークビーム条
 件では明瞭であった

全く別な話ですが、つづけてさせていただき・・・



位相イメージング法による 日本刀の観察

DEI法と単スリット法による観察の比較

岡本博之¹, 水野 薫², 森川公彦² ¹金沢大医薬保健, ²島根大総合理工

日本刀とは?

- 日本刀(にほんとう)は、日本固有の鍛冶製法によって作られた刀類の総称
- 一般に、反りがあり刀身の片側に刃がある刀剣
- 焼入れにより、刀の表面にはマルテンサイトと呼ばれる非常に固い組織が現れる。マルテンサイトの入り方によって、肉眼で地鉄の表面に刃文が丸い粒子状に見えるものを錵(にえ)または沸(にえ)と呼び、1つ1つの粒子が見分けられず細かい白い線状に見えるものを匂(におい)と区別する。

 日本刀断片を用いて、焼入れにより刀剣内に生じる マルテンサイト等の組織の分布を、2種類の位相イ メージング法により観察する



DEI装置の概略

DEI:Diffraction-Enhanced X-ray Imaging



アナライザーを回転させたときの、ロッキングカーブ



試料によりX線に屈折が生じる⇒アナライザーへの入射角が変化する →ロッキングカーブに従って回折強度が変化する

DEI法とは、アナライザーにより**屈折角**Δθをコントラストに変換する手法 特徴: 屈折角の変化を高感度に検出できる(屈折角分解能が良い)





CCDカメラi番目のピクセル位置 y_i における強度 I_i

このような統計量 を計算すれば各情 報が得られる

積分強度:
$$I_{int} = \sum_{i=1}^{n} I_i$$

重心位置: $y_{ex} = \sum_{i=1}^{n} \frac{I_i}{I_{int}} y_i$
標準偏差: $S = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \frac{I_i}{I_{int}}} (y_{ex} - y_i)^2$

単スリット法で画像化する量

試料有りと無しの場合で左記統計量を計算し、以下の量を求め画像化する 吸収像: I/I_0 (I_0 :試料無しの積分強度、I:試料が有りの積分強度)

屈折像: $\Delta \theta = \Delta y_{ex}/L$ (Δy_{ex} : 試料有りと無しのときの重心位置の変化, L: 試料-CCDカメラ間距離)

散乱像: S/S_0 (S_0 : 試料無しの標準偏差, S: 試料有りの標準偏差)

宣伝

高品質なSi結晶や,高精度な干渉格子を使用せず,設置・調整に高度な技 術を必要としない,誰でも撮影できるような,単純な原理,単純な装置で吸収 像,位相像,散乱像を取得することが可能

欠点:空間分解能がスリット幅による制限を受ける。屈折角分解能があまり 高くない(撮影条件の検討が必要)。

単スリット法装置と撮影条件



線源-スリット-試料-CCDカメラ を直線的に配置 回折条件を探すような微妙な調整は一切不要

実験施設:KEK-PF BL-14B(写真), BL-20B X線エネルギー:, 24keV (DEIは35keV) 試料-CCDカメラ間距離L:750mm スリット幅:10µm CCDカメラピクセルサイズ:6.4µm



約600年前に製作された日本刀「沖光」より 切り出した厚さ0.2mmの断面







DEI法

10mm

刃の先端部 付近につい ては、黒点 または白点 の密度が特 に高い







低角像



高角像

DEI法(刃)

散乱

5mm



低角像

高角像

低角像と高角像で点のコントラストが反転しているか不明➡正体不明



10mm

散乱像で表面付 近の散乱比が高 い







散乱像

単スリット法

5mm





屈折像



まとめ1

DEI法

- 特に、刃の部分で白点または黒点が高密度で観察された
- ピーク、高角、低角像で点にコントラスト変化が有ったため、 点は密度(屈折率)の異なる部分であると思われる(高密度 か低密度かは不明)
- 点は焼き入れに伴う、マルテンサイト変態により生じたと炭素量の異なる部分だと思われる
- DEI法では吸収、屈折、散乱の区別が難しいので詳細は不明

まとめ2

単スリット法

- DEI法と同様に、刃の表面付近で点の密度が高く観測された
- 吸収像から、点が白く観察されたため、吸収が少ない部分であると考えられる
- 屈折像から、点は白黒対で観察されたため屈折が生じており、
 周囲と密度(屈折率)が異なる部分であると考えられる
- 散乱像から、全体的に白っぽく(散乱比S/Soが高く)特に表面付近では白くなっており、(分解能不足により)観測できない微細な点により散乱が生じていると考えられる
- 大きな点では、散乱比S/S₀が1より小さく(暗く)なっているため、 点がレンズのような作用をしていると考えられる。
 - ➡ 点の部分は周囲より密度が小さい(屈折率が1に近い)と 考えられる
- 点の部分は周りに比べ、低吸収、低密度の物質(炭素リッチ?)
 が集合した部分であると考えられる

